

Webcast

La Importancia de las Regiones Sólidas y los PADS Térmicos en el Diseño PCB

Descripción

Dentro de los avances que se han generado en la electrónica, la miniaturización de los componentes es uno de los más importantes. Empaquetados como SOIC, QFP, PLCC, BGA son un reto para el diseñador, especialmente en el aspecto térmico. Como diseñadores debemos tener los principios de diseño claros para hacer un buen uso de estos elementos y garantizar que su funcionamiento sea el adecuado.

Dirigido a

Ingenieros, diseñadores, maestros, investigadores y estudiantes interesados en el uso y conocimiento de las herramientas de diseño avanzadas para el campo de la electrónica.

Objetivo

Presentar las diferentes formas para la disipación de calor en los componentes electrónicos. Mostrar los diferentes tipos de Pads térmicos usados en el ensamblaje de componentes. Presentar algunos consejos importantes para la soldadura de este tipo de componentes. Explicar el impacto que tienen los PADS térmicos en el desarrollo de tarjetas de múltiples capas.

Temario

Métodos para la disipación de calor Diferentes tipos de encapsulados y sus características Métodos para el diseño de Pads térmicos Buenas prácticas para el diseño de pads térmicos ¿Cómo puede afectar el diseño y uso de Pads térmicos los demás espacios del PCB?

Instructores

Gerson David Cruz Capador

Ingeniero Electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Maestrante en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes. Amplia experiencia como ingeniero de desarrollo electrónico en empresas del sector aeroespacial y petrolero. Docente universitario en Ingeniería Electrónica y Mecatrónica en el área de sistemas embebidos y electrónica, instructor especializado en herramientas de desarrollo electrónico como Altium y PADS de Mentor Graphics. Acreditado con la Certificación IPC Certified Designers CID.

Información General

Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Vie. 20 de Ene de 2017

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m

México D.F. 10:00 a.m

Bogotá 11:00 a.m

Quito 11:00 a.m

Lima 11:00 a.m

Caracas 11:30 a.m

Bolivia 12:00 m

Buenos Aires 1:00 p.m

Santiago 1:00 p.m

Herramientas de apoyo



Políticas

Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link <https://www.software-shop.com/formacion/politicas>

Inscríbete ahora